

证券代码：688469

证券简称：芯联集成

公告编号：2024-010

**芯联集成电路制造股份有限公司**  
**关于第一期股票期权激励计划第一个行权期**  
**第三次行权结果暨股份变动的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

**重要内容提示：**

- 本次行权股票数量：1,144,875股，占行权前公司总股本的比例为0.02%。
- 本次行权股票上市流通时间：本次行权股票自行权日起满三年可上市流通，预计上市流通时间为2027年2月5日（如遇非交易日则顺延）。

**一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露**

芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月制定并实施《绍兴中芯集成电路制造股份有限公司第一期股票期权激励计划》，合计向568名激励对象授予6800万份股票期权，行权价格为2.78元/股。

1、2021年9月13日，公司召开第一届董事会第三次会议并形成董事会决议，审议通过了《关于公司第一期股票期权激励计划的议案》等与本次激励计划相关的议案。同日，公司召开第一届监事会第三次会议并形成监事会决议，审议通过了《关于核实公司第一期股票期权激励计划名单的议案》等与本次激励计划相关的议案。

2、2021年9月28日，公司召开了2021年度第二次临时股东大会并形成股东大会决议，审议通过了《关于公司第一期股票期权激励计划的议案》等与本次激励计划相关的议案，公司于同日完成了股票期权的授予（本次激励计划不设预留权益），实际授予激励对象为568名公司员工，共分为两个行权期，每期可行

权 50%，每期的行权条件为同时满足当期公司层面考核条件与激励对象个人考核条件。

3、2022 年 7 月 14 日，公司召开第一届董事会第九次会议并形成董事会决议，审议通过了《关于公司第一期股票期权激励计划第一个行权期考核条件达成情况的议案》等与本次激励计划相关的议案，除离职员工外，参与第一个行权期考核的激励对象共 514 名，根据公司层面考核结果以及激励对象个人考核结果，实际达成激励计划第一个行权期考核条件的激励对象共 502 名。

4、2023 年 6 月 13 日，公司召开第一届董事会第十五次会议并形成董事会决议，审议通过了《关于注销部分员工期权的议案》，独立董事对此发表了同意的独立意见。同日，公司召开第一届监事会第八次会议并形成监事会决议，审议通过了《关于核实公司第一期股票期权激励计划第一个行权期可行权激励对象名单的议案》，并发表了核查意见。鉴于部分激励对象因离职丧失适格人士的资格，不再符合行权条件，在达成激励计划第一个行权期考核条件的激励对象中，实际可行权激励对象为 449 名。上述内容详见公司于 2023 年 6 月 14 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告。

5、2023 年 9 月 7 日，公司第一期股票期权激励计划第一个行权期第一次行权新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。本次行权的激励对象为 358 人，行权股票数量为 20,767,475 股，自行权日起三年后可上市流通，预计上市流通时间为 2026 年 9 月 7 日（如遇非交易日则顺延）。行权后，公司总股本由 7,021,800,000 股变更为 7,042,567,475 股。上述内容详见公司于 2023 年 9 月 9 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告。

6、2023 年 11 月 27 日，公司第一期股票期权激励计划第一个行权期第二次行权新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。本次行权的激励对象为 41 人，行权股票数量为 2,034,800 股，自行权日起三年后可上市流通，预计上市流通时间为 2026 年 11 月 27 日（如遇非交易日则顺延）。行权后，公司总股本由 7,042,567,475 股变更为 7,044,602,275 股。上述内容详见公司于 2023 年 11 月 29 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告。

## 二、本次股权激励计划行权的基本情况

### （一）激励对象行权的股份数量

序号	姓名	职务	已获授予的股票 期权数量（股）	本次行权数量 （股）	本次行权占已 授予期权总量 的百分比
一、董事、高级管理人员及核心技术人员					
本次无董事、高级管理人员及核心技术人员参与行权。					
二、其他激励对象					
其他激励对象 449 人			54,912,800.00	1,144,875.00	2.08%
合 计			54,912,800.00	1,144,875.00	2.08%

### （二）本次行权股票来源情况

本次行权股票来源于公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。

### （三）行权人数

达成公司激励计划第一个行权期考核条件实际可行权激励对象为 449 名，其中参与本次行权的人数为 29 人。

## 三、本次股权激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况

### （一）本次行权股票的上市流通日。

本次行权股票自行权日起满三年可上市流通，预计上市流通时间为 2027 年 2 月 5 日（如遇非交易日则顺延）。

### （二）本次行权股票的上市流通数量：1,144,875 股。

### （三）董事、高级管理人员和核心技术人员本次行权股票的锁定和转让限制。

本次无董事、高级管理人员和核心技术人员参与行权。其他激励对象在公司上市后因行权所获得的股票，自行权日起 3 年内不得减持；上述禁售期限届满后，激励对象应比照公司董事、监事及高级管理人员的相关减持规定执行。

### （四）本次股本结构变动情况

单位：股

类别	本次变动前	本次变动数	本次变动后
----	-------	-------	-------

股本总数	7,044,602,275	1,144,875	7,045,747,150
------	---------------	-----------	---------------

本次股份变动后，公司仍无实际控制人。

#### 四、验资及股份登记情况

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年1月16日出具了《芯联集成电路制造股份有限公司验资报告》（天职业字[2024]2669号），审验了公司截至2024年1月13日止的新增注册资本实收情况。

截至2024年1月13日，本次行权实际由29名激励对象认购1,144,875股，行权价格为每股2.78元，公司共计收到投资款3,182,752.50元。本次行权后公司增加股本人民币1,144,875.00元，增加资本公积人民币2,037,877.50元。本次变更后公司的注册资本为7,045,747,150.00元，累计实收股本人民币7,045,747,150.00元。

本次行权新增股份已于2024年2月5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

#### 五、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响

本次行权的股票期权数量为1,144,875股，占行权前公司总股本的比例为0.02%，本次行权后，公司总股本将由7,044,602,275股变更为7,045,747,150股。本次行权未对公司股权结构造成重大影响。

公司2023年第三季度末基本每股收益为-0.23元，每股净资产为1.85元。公司第一期股票期权激励计划第一个行权期第二次行权后，以行权后总股本7,044,602,275股为基数计算，基本每股收益为-0.23元，每股净资产为1.85元。本次行权后，以行权后总股本7,045,747,150股为基数计算，基本每股收益为-0.23元，每股净资产为1.85元。本次行权对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

芯联集成电路制造股份有限公司董事会

2024年2月7日